

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-023

## 沪士电子股份有限公司

### 关于暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的 高层高密度互连积层板研发与制造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2021年2月1日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，决议在昆山青淞厂投资新建“应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目”（下称“本项目”），本项目总投资预计约为19.8亿元人民币，具体内容详见2021年2月2日公司在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的公告》。

2022年3月21日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，同意公司暂缓实施本项目的建设。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本项目暂缓实施的原因

由于外部政经环境的变化，市场需求面临更多的不确定性，根据公司实际经营情况，公司规划将昆山青淞厂16层以下PCB产品加速向全资子公司黄石沪士电子有

限公司（下称“黄石厂”）转移。黄石厂管理团队经验累积和管理效率提升已见成效，公司将在黄石厂相应针对性的扩充产能，以满足客户需求，应对价格竞争。在向黄石厂转移产能的同时，对昆山青淞厂优先采用更新改造瓶颈制程的方式进行升级，暂缓其新厂房的建设。

鉴于本项目还处于前期市场与技术培养阶段，通过更新改造相关制程也可以满足目前所需的产能、技术与设备投入，并不影响公司在相应技术与市场的发展进程，经公司董事会战略委员会提议，出于审慎考虑公司暂缓实施本项目的建设。

### 三、本项目暂缓实施对公司的影响

由于本项目还处于前期市场与技术培养阶段，通过更新改造相关制程也可以满足目前所需的产能、技术与设备投入，本项目暂缓实施并不影响公司在相应技术与市场的发展进程；由于本项目尚未实际投入新建，本项目暂缓实施对公司的生产经营及业绩不会产生重大不利影响；后续公司将根据外部环境、市场需求的发展与变化以及公司经营具体情况，择机再启动本项目的建设，并及时履行信息披露义务。

### 四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目，是公司审慎应对当前市场环境，根据实际情况作出的合理调整，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。作为公司独立董事，对此我们表示同意。

### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议。
- 2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日